#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-43675 (P2002-43675A)

(43)公開日 平成14年2月8日(2002.2.8)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)	
H01S	5/022		H01S	5/022		2H037	
G02B	6/42		G 0 2 B	6/42		5 F O 7 3	
H01L	31/02		H01L	31/02	E	3 5F088	

# 審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 6 頁)

			_
(21)出願番号	特願2000-223328(P2000-223328)	(71) 出願人	000004008 日本板硝子株式会社
(22)出顧日	平成12年7月25日(2000.7.25)		大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番28号
	十成12年1万25日(2000.1.25)	(	
		(72)発明者	田中裕之
			大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号
•			日本板硝子株式会社内
		(72)発明者	橋爪 秀樹
		(-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号
			日本板硝子株式会社内
		(74)代理人	100078961
			弁理士 茂見 穣
			71-12-17-17-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-
		l	

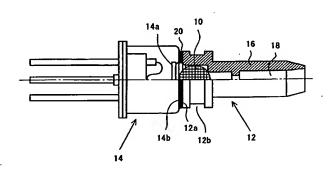
### 最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 光モジュール

### (57)【要約】

【課題】 細径化してLC型やMU型など小型の光コネクタにも対応できるようにする。ダブレットタイプなどにも容易に適用できるように小型化する。

【解決手段】 キャップ封止型の光半導体素子14が、内部に光部品を収容しているハウジング12に対して、該光部品の光軸上に位置するように芯だしして取り付けられている。その際、光半導体素子のキャップ上面とハウジングの端面が衝き合わされて接着(紫外線硬化型接着剤20)固定されている。この構造の光モジュール本体を用い、光半導体素子のキャップ側面とハウジング側面の少なくとも一部を覆うようにケーシングを被せて樹脂封止することもできる。



【請求項1】 キャップ封止型の光半導体素子が、内部 に光部品を収容しているハウジングに対して、該光部品 の光軸上に位置するように芯だしして取り付けられてい る光モジュールにおいて、

光半導体素子のキャップ上面とハウジングの端面が衝き 合わされた状態で接着固定されていることを特徴とする 光モジュール。

【請求項2】 キャップ封止型の光半導体素子が、レン ズを内蔵すると共に接続相手の光プラグのフェルールを 10 嵌合保持する構造のハウジングに対して、該レンズの光 軸上に位置するように芯だしして取り付けられている光 モジュールにおいて、

光半導体素子のキャップ上面とハウジングの端面が衝き 合わされた状態で接着固定されていることを特徴とする 光モジュール。

【請求項3】 光半導体素子のキャップ側面とハウジン グ側面の少なくとも一部を覆うようにケーシングを被せ て間隙部を樹脂封止した請求項1又は2記載の光モジュ

【請求項4】 光半導体素子のキャップ上面とハウジン グの端面は紫外線硬化型接着剤で接着固定され、ケーシ ング内面と光半導体素子のキャップ側面及びハウジング 側面の少なくとも一部の間隙部は熱硬化性樹脂で封止さ れている請求項3記載の光モジュール。

【請求項5】 請求項1又は2記載の光モジュールが複 数個並置され、それらに共通のケーシングを被せ、間隙 部が樹脂封止されている光モジュール。

### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、キャップ封止型の 光半導体素子と、内部に光部品を収容しているハウジン グとを、光学的最適位置関係で衝き合わせ接着固定した 細径構造の光モジュールに関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】光モジュールは、光半導体素子(例えば レーザダイオード等の半導体発光素子あるいはフォトダ イオード等の半導体受光素子)と光部品(例えばレンズ や光ファイバフェルール等)とを調芯保持したデバイス である。光通信分野において使用されている光モジュー 40 ルとしては、例えば、光半導体素子と、レンズと、前記 光半導体素子やレンズを保持すると共に接続相手の光プ ラグのフェルールを嵌合保持するハウジングから構成さ れ、光プラグ接続時に光半導体素子とフェルールの光フ ァイバとがレンズを介して光学的に結合する構造があ る。光ファイバとの光学的結合は、通常、各種光コネク タの標準規格に準拠した機械的構造による。

【0003】光モジュールに組み込むレンズとしては、 機械加工のみによって高精度の製品を容易に製造できる ため安価であり、且つ方向性が全く無いためにレンズ実 50 だしして取り付けられている光モジュールである。ここ

装の際の方位調整が不要で組み立て易いという利点もあ って、球レンズが多用されている。その他、非球面レン ズや屈折率分布型ロッドレンズ等も用いられる。光半導 体素子やレンズを保持するハウジングは、かつては金属 製のハウジングが多用されていたが、最近はレンズをイ ンサートモールドで内蔵したり複数の爪状突起で抱持す ることが可能なことなど、製作性が優れ且つコストを低 減できるといった観点から樹脂製のハウジングが用いら れることも多い。光半導体素子としては、通常、素子本 体を窓付きキャップ内に装着して封止した所謂キャップ 封止構造のものが多く用いられている。

【0004】光モジュールを製造する際には、通常、光 半導体素子、レンズ、ファイバを光学的に最適な位置関 係に調芯し、レンズを内蔵しているハウジングに光半導 体素子を固定する。例えば光半導体素子がレーザダイオ ードの場合、レーザダイオードを動作させ、その出射光 を光ファイバから取り出し、取り出したレーザ出射光の 光量が最大になる位置で、ハウジングと光半導体素子を 固定する。

【0005】キャップ封止型光半導体素子を用いた従来 の光モジュールでは、ハウジング内に光半導体素子のキ ャップを挿入可能な構造になっており、光半導体素子の ステム部とハウジングの端面とを接合している。ハウジ ングが樹脂製の場合には各種の接着剤を用い、金属製の 場合にはYAG溶接することもある。いずれにしてもハ ウジングの一部が光半導体素子のキャップ側面全周を覆 うような状態で接合されている。

### [0006]

【発明が解決しようとする課題】近年、光通信容量の増 大に伴って、光伝送装置などでは光ファイバを高密度実 装する必要性が高まっている。このため、これらに搭載 される光モジュールも、より一層の小型化が要求されて いる。具体的には、従来のSC型光コネクタからLC型 やMU型など小型の光コネクタへの対応が求められてい る。

【0007】しかし、上記のようにキャップ封止型光半 導体素子を用いた従来の光モジュールでは、光モジュー ルの外径は、必然的に光半導体素子のステム部の直径よ りも大きくなり、小型化・細径化が制限されていた。

【0008】本発明の目的は、小型の光モジュールを提 供することである。本発明の他の目的は、LC型やMU 型など小型の光コネクタにも対応できる光モジュールを 提供することである。本発明の更に他の目的は、ダブレ ットタイプなどにも容易に適用できる小型の光モジュー ルを提供することである。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、キャップ封止 型の光半導体素子が、内部に光部品を収容しているハウ ジングに対して、該光部品の光軸上に位置するように芯

で本発明では、光半導体素子のキャップ上面とハウジングの端面が衝き合わされた状態で接着固定されており、その点に特徴がある。従って、光モジュールの最大外径を光半導体素子の最大外径以下に収めることが可能となる。

【0010】ハウジング内に収容する光部品としては、例えばレンズや光ファイバフェルールなどがある。ハウジングは、レンズを内蔵するだけの構造でもよいし、レンズを内蔵すると共に接続相手の光プラグのフェルールを嵌合保持する構造などでもよい。後者の場合には、キャップ封止型光半導体素子をレンズ及びフェルールの光軸上に位置するように芯だししてハウジングと光半導体素子とを固定する。本発明は、光半導体素子とフェルールボアを直接接着する光モジュールにも適用できる。通常、ハウジングは合成樹脂製であり、ハウジングと光半導体素子のキャップ上面との接合には紫外線硬化型接着剤が好ましいが、他の接着剤を用いてもよい。

【0011】また本発明には、上記の光モジュールを用い、光半導体素子のキャップ側面とハウジング側面の少なくとも一部を覆うようにケーシングを被せて間隙部を樹脂封止した構成もある。この構成においては、光半導体素子のキャップ上面とハウジングの端面は紫外線硬化型接着剤で接着固定され、ケーシング内面と光半導体素子のキャップ側面及びハウジング側面の少なくとも一部の間隙部は熱硬化性樹脂で封止されている構造が好ましい。紫外線硬化型接着剤による接着は、極く短時間で接着できるため光学的最適位置での結合作業が容易となるし、熱硬化性樹脂を用いた封止により接着強度及び耐候性能の向上を図ることができる。

【0012】更に本発明には、上記の光モジュールを複数個並置し、それらに共通のケーシングを被せ、間隙部が熱硬化性樹脂で封止されている構造もある。この典型的な例は、半導体発光素子と半導体受光素子を組として一体化したダブレットタイプの光モジュールである。

#### [0013]

【0014】樹脂ハウジング12は、全体がほぼ筒形状を呈する一体成形品であり、一方の端面12aが光半導体素子14の取り付け面、一端内側部分が球レンズ固定部、反対側がレセプタクル部16となっており、球レンズ固定部の外周には全周にわたって溝12bが形成され 50

ている。レセプタクル部16は、接続相手の光プラグのフェルールが丁度嵌入するボア(空洞部)18を有する部分である。この例では、フェルールを受け入れるボア18の内径は直径1.25mmである。

【0015】球レンズ固定部は、球レンズ10をスナップイン圧入あるいは接着・溶着等により固定できる構造である。例えばスナップイン圧入構造の場合は、この球レンズ固定部は、中心軸の周囲に、先端部が光半導体素子の方に向かって突出し且つ内周側に膨出(オーバーハング)した複数の爪状突起によって構成される。これらの爪状突起は、樹脂ハウジング本体部分とともに射出成形法によって一体的に成形される。球レンズ圧入時に、爪状突起は、樹脂の靭性によって外向きに撓んで内部に球レンズを受け入れ、該球レンズはレンズ着座面に当接して位置決めされる。その状態で、爪状突起は元の形状に戻ろうとし、その復元反力で該球レンズは抱持固定される。

【0016】このように球レンズ10を内蔵した樹脂ハウジング12に、光半導体素子14を取り付ける。ここで光半導体素子14は、そのキャップ上面(窓部14aの外周部分)14bが樹脂ハウジング12の端部12aに衝合し、最終的に最適な光学的位置になるように調芯位置決めされた状態で接着固定される。

【0017】本実施例では、この接着固定に紫外線硬化型接着剤20を用いている。光半導体素子のキャップ上面とハウジング端面との接着は、光半導体素子の熱的損傷を避けるために極力低温で行う必要があり、また光学的調芯後、短時間で固定することが好ましい。紫外線硬化型接着剤による接合は、このような条件を満たすことができるため最適である。この接着で、後工程でのハンドリングに十分な強度(引っ張り強度は19.6N以上)を確保できる。

【0018】紫外線硬化型接着剤の塗布状態を図2に示す。Aは樹脂ハウジングの半断面図であり、Bは平面図である。樹脂ハウジング12を、その一端面(光半導体素子に接合する端面)が上方を向くようにして、粘度45Pa・s程度の紫外線硬化型エポキシ接着剤(白色不透明、Tg=100℃)20を、自動又は手動の回転塗布機によって、ハウジング端面12aに円周状に塗布する。接着剤の塗布高さhは0.1~0.25㎜程度である。

【0019】図3に具体的な接着操作の状態を示す。図2に示すように紫外線硬化型接着剤を塗布した樹脂ハウジング12を接着剤塗布面が上を向くように固定ステージ(図示するのを省略)に固定し、他方、光半導体素子(レーザダイオード)14をキャップ上面(窓部を有する面)が下方を向くように素子保持工具30で保持する。そして、ハウジング端面とキャップ上面とが50~250μm程度の空隙を維持した状態で光学的な芯出しを行う。即ち、光半導体素子(レーザダイオード)14

からレーザ光を出射し、ボアに装着した光プラグフェルールの光ファイバ (図示せず) からの出射光をモニタして、最大光量が得られるように取付位置を調整する。

【0020】光学的最適位置に設定したならば、紫外線照射装置により紫外線を照射する。ここで紫外線照射装置は、中心波長365mm、出力200Wのメタルハライドランプを備え、出射径5m程度の2分岐光ファイババンドル32によって目的の領域を照射できるような構造である。紫外線の照度は、光ファイバ1本当たり平均1500~2000mW/cm²である。実際の照射は、このような紫外線照射装置を2台用意し、4方向(90度ピッチ)から行った。紫外線照射は、図3に示すように、水平面に置かれた樹脂ハウジング12に対して水平方向から約10mm離れた位置に光ファイババンドル32の出射端を固定して10秒間程度行った。紫外線照射中、樹脂ハウジング12と光半導体素子14は調芯状態が変化しないように、固定ステージと素子保持治具30によって保持し続けた。

【0021】図4は本発明に係る光モジュールの他の実施例を示す説明図である。この実施例では、図1に示した前記実施例の光モジュールをそのまま光モジュール本体として用いており、それ故、対応する部材に同一符号を付し、それらについての説明は省略する。

【0022】この実施例は、前記の光モジュール本体4 0を構成している光半導体素子のキャップ側面とハウジ ング側面の少なくとも一部を覆うように樹脂製のケーシ ング42を被せて間隙部を樹脂44で封止した構造であ る。図5に示す組立説明図から明らかなように、ケーシ ング42は、ほぼ円筒状をなし、内周に段差部42aが 形成されて薄肉部分42bと厚肉部分42cとが連続 し、厚肉部分42cの外周面に全周にわたって溝42d が形成されている。 薄肉部分42bの内径は、光半導体 素子14のキャップ外径より若干大きく設定され、厚肉 部分42cの内径は、ハウジング12のレセプタクル部 16の外径にほぼ一致し、薄肉部分42bの長さは、ハ ウジング12のレセプタクル部端12cの位置から光半 導体素子14のステム部14cまでの距離に一致する か、それよりも若干短めに設定されている。従って、図 6に示すように、光モジュール本体40にケーシング4 2を被せた時に、ケーシング内の段差部42aがハウジ 40 ング12のレセプタクル部端12cに当接し、厚肉部分 42cの内周面がレセプタクル部16の基端部分の外周 面に密接した状態となり、薄肉部分42bと光半導体素 子14のキャップ側面とは僅かな間隙を有し、薄肉部分 42 bと球レンズ固定部との間にはある程度の空間が形 成されることになる。

【0023】ケーシング42の薄肉部分42bには、球レンズ固定部に対向する1箇所もしくは複数箇所(周方向で均等に)に、予め樹脂注入のために径方向の貫通穴46(例えば、直径0.7㎜程度)を形成しておく。

【0024】光モジュール本体40をケーシング42に挿入し、該ケーシング側面に設けた貫通穴46から、熱硬化性エポキシ樹脂(粘度15Pa・s、Tg=110℃)をニードルによって注入する。その後、100℃で2時間以内の加熱処理を行い、硬化させる。これによって、光半導体素子とハウジングの間隙部は紫外線硬化型樹脂44にり封止され、且つ全体が強固に結合される。

【0025】つまり、この構成においては、光半導体素子のキャップ上面とハウジングの端面は紫外線硬化型接着剤で接着固定され、ケーシング内面と光半導体素子のキャップ側面及びハウジング側面の少なくとも一部の間隙部は熱硬化性樹脂で封止されている。従って、紫外線硬化型接着剤による接着は、極く短時間で接着できるため光学的最適位置での結合作業が容易となるし、熱硬化性樹脂を用いた封止により接着強度及び耐候性能の向上を図ることができる。

【0026】更に本発明の他の実施例としては、図示するのを省略するが、上記の光モジュール本体を複数個並置し、それらが共通のケーシングで覆われ、熱硬化性樹脂で封止されている構造もある。この典型的な例は、半導体発光素子と半導体受光素子を組として一体化したダブレットタイプの光モジュールである。これには、ケーシングの構造を変えるだけで対応できる。

【0027】なお、上記の各実施例では光モジュール本体の組み立てに紫外線硬化型接着剤を用いているが、それに限らず部材の材質などに応じて任意の接着剤、接合方法を用いてよいことは言うまでもない。レンズの形状や構造、レンズの固定構造なども任意でよい。ケーシングの構造、光モジュール本体の配列本数なども任意である。

### [0028]

【発明の効果】本発明は上記のように、光半導体素子のキャップ上面に直接、ハウジングの端面を接合固定した構造であるため細径化が可能であり、従来技術では不可能であった外径5.6m以下の光モジュールを実現できる。そのため、LC型やMU型など小型の光コネクタにも対応可能となる。

【0029】また本発明では、光モジュールの外殻を構成するケーシングへの組み付けが、光半導体素子とハウジングとの接合の後に独立に行えるために、ダブレットタイプの光モジュールなどへも容易に適用でき、一層の小型化が可能となる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る光モジュールの一実施例を示す説明図。

【図2】ハウジングへの紫外線硬化型接着剤の塗布状態 を示す説明図。

【図3】接着工程を示す説明図。

【図4】本発明に係る光モジュールの他の実施例を示す説明図。

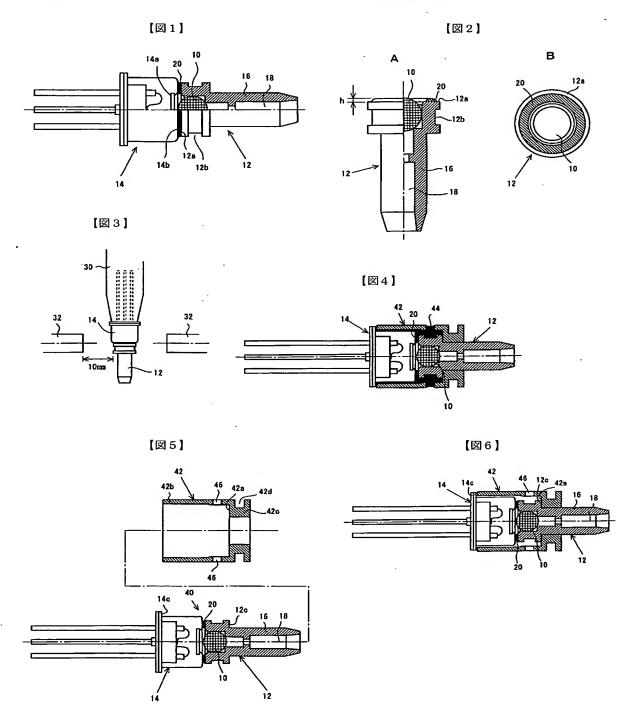
【図5】その組立説明図。

【図 6 】 光モジュール本体のケーシングへの挿入状態を示す説明図。

# 【符号の説明】

- 10 球レンズ
- 12 樹脂ハウジング

- 14 光半導体素子
- 16 レセプタクル部
- 18 ボア
- 20 紫外線硬化型接着剤
- 42 ケーシング
- 44 熱硬化型樹脂



# フロントページの続き

F 夕一ム(参考) 2H037 AA01 BA03 BA12 DA03 DA05 DA06 DA18 DA35 5F073 AB27 AB28 FA06 5F088 BA16 BA18 BB01 JA06 JA12 JA14 JA20

٠..

.

.

.